



即时发表

经办代理:

David Moreno (大卫 穆锐农)

**Open Sky Communications**

电话: +1-415-519-3915

电邮: [dmoreno@openskypr.com](mailto:dmoreno@openskypr.com)

**EBEAM INITIATIVE 半导体业界精英调查预测光罩市场增长，对光罩检测及多电子束光罩刻写投资也会增加**

**第 13 届年度专家调查结果将在 SPIE 光罩技术 + EUV 光刻会议期间的现场活动中公布**

加利福尼亚州，圣何塞，2024 年 10 月 1 日——eBeam Initiative 是一个致力于推广基于电子束（eBeam）技术的新型半导体制造方法的论坛，今天宣布完成第 13 届年度 eBeam Initiative 业界精英调查。今年的调查吸引了来自半导体生态系统各领域的 49 家公司代表参加，其中包括光罩、电子设计自动化（EDA）、芯片设计、设备、材料、制造和研究等领域。

所有调查参与者预测，2024 年的光罩营收将较 2023 年增加（74%）或保持不变（26%）。专家们对未来三年设备采购前景也持积极态度，预计多电子束光罩刻写机（93%）、光罩检测（85%）和激光光罩刻写机（48%）的需求将增加。此外，认为非 EUV 工厂在 7 年内可以达到 5 纳米的专家比例从去年的 12%上升到了今年的 19%。

今年的业界精英调查新增了对 EUV 光罩保护膜和高数值孔径（NA）拼接的看法的相关问题。81% 的受访者认为，在设计高 NA EUV 光罩时，设计人员需要考虑拼接边界。33% 的受访者认为，使用光罩保护膜后，EUV 光罩的使用寿命至少比不使用时延长 3 倍。

业界精英调查的完整结果将在今晚于加利福尼亚州蒙特雷市(Monterey)举办的 SPIE 光罩技术+EUV 光刻会议期间由 eBeam Initiative 主办的活动上，由专家小组讨论，并将在活动结束后于 [www.ebeam.org](http://www.ebeam.org) 网站上提供



## 业界精英调查其它要点（2024 年 7 月进行）

- 74% 的受访者认为，曲线形状的逆向光刻技术（curvilinear ILT）对非 EUV 的 193i 前沿节点有用——其中 29% 的人强烈同意这一说法，而去年这一比例为 24%。
- 55% 的受访者表示，前沿节点的一些关键层已经在使用逆向光刻技术（ILT），这一比例较去年的 46% 和两年前的 35% 有所上升。
- 光罩制造中的软件基础设施仍然是生产曲线形状光罩的最大挑战。
- 对深度学习应用的预测有所延迟，今年有 54% 的受访者预测深度学习将在 2025 年之前成为光罩制造过程中任何环节的竞争优势，而去年这一预测为 2024 年。

“我们期待在 SPIE 光罩技术会议期间度过激动人心的一周，届时 eBeam Initiative 将举办第 15 届年度光罩会议，展示半导体生态系统对这一合作论坛的持续支持，”eBeam Initiative 的主办管理公司 D2S 的首席执行官藤村 (Aki Fujimura) 表示。“现在是加入光罩行业的绝佳时机，近年来该行业取得了强劲增长——这证明了光罩社区内杰出人才的贡献，也彰显了该行业在推动半导体创新方面的重要性。今年 eBeam Initiative 业界精英调查的绝大多数参与者——他们代表了行业内顶尖的商业和技术专家——都认为这一增长趋势将在 2024 年继续，这无疑是个好消息。”

### **About The eBeam Initiative**

#### **关于 eBeam Initiative（电子束倡议团）**

eBeam Initiative 是一个致力于推广和倡导电子束技术在半导体制造全新应用的团体；为有关电子束技术的教育和促进活动提供相应的论坛。eBeam Initiative 的目标是增加电子束技术应用在半导体制造各领域中的投资；降低电子束技术应用的障碍，能够使更多集成电路设计完成，并且更快投进市场成为可能。会员公司，涵盖整个半导体生态系统，包括：aBeam Technologies; Advantest; Alchip Technologies; AMD; AMTC; Applied Materials; Artwork Conversion; ASML; Averroes.ai; Cadence Design Systems; Canon; CEA-Leti; D2S; Dai Nippon Printing; EQUIcon Software GmbH Jena; ESOL; EUV Tech; Fractilia; Fraunhofer IPMS; FUJIFILM Corporation; Fujitsu Semiconductor Limited; GenISys GmbH; GlobalFoundries (GF); Grenon Consulting; Hitachi High-Tech Corporation; HJL Lithography; HOLON CO., LTD; HOYA Corporation; IBM; imec; IMS CHIPS; IMS Nanofabrication AG; JEOL; KIOXIA; KLA; Micron Technology; Multibeam Corporation; NCS; NuFlare Technology; Petersen Advanced Lithography; Photronics; QY Mask; Samsung Electronics; Semiconductor Manufacturing International (Shanghai) Corporation (SMIC); Siemens EDA; STMicroelectronics; Synopsys; TASMITE; Tokyo Electron Ltd. (TEL); TOOL Corporation; Toppan Photomask Corporation; UBC Microelectronics; Vistec Electron Beam GmbH and ZEISS. eBeam Initiative 面向和欢迎所有电子工业的公司和协会加盟。细节请查看 [www.ebeam.org](http://www.ebeam.org).

###